



Investor Relations
2019



LBSemicon



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 LB세미콘㈜(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 ‘자본시장과
금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를
거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을
의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로
인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation
실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에
따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는
투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

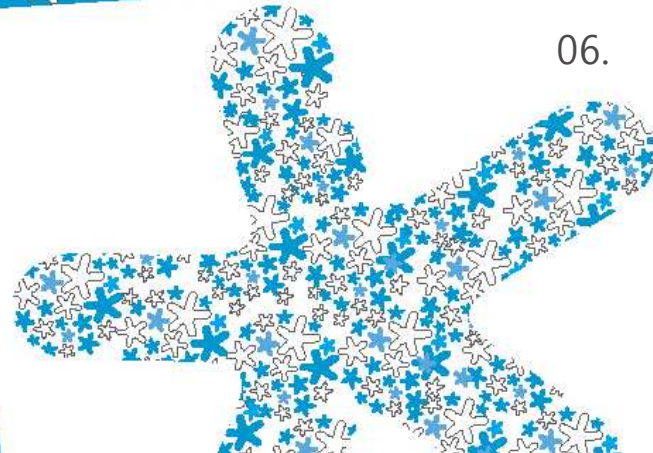


LBSemicon

Contents

- I. Company Overview
- II. Investment Highlights
- Appendix





Chapter 1:

Company Overview

01. Company Identity
02. Company Profile
03. Milestone
04. Business Area
05. Business Chain for DDI
06. Financial Highlights



01.

Company Identity



LB Semicon

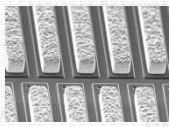
Flip Chip 공정 중 핵심인 Bump 공정, Probe test 및 Assembly 일부 공정 사업 영위



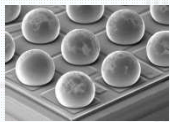
LB Semicon



Bumping



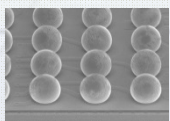
- Au Bump



- Solder Bump



- Cu Pillar Bump



- WLCSP



Probe Test



- DDI, PMIC, CIS, SOC
- Test



Backend



- COG, T&R



02. Company Profile

★ Company Snapshot



회 사 명	엘비세미콘㈜
설 립 일	2000년 2월 10일
대 표 이 사	박 노 만
자 본 금	219 억원
임 직 원 수	472 명
주 소	경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138
주 요 제 품	Bumping, Probe Test, Backend
홈 페이지	www.lbsemicon.com

★ CEO Profile



대표이사 박 노 만

- 경북대 전자공학과
- LG반도체
- 매그나칩반도체
- 現 LB세미콘(주) 대표이사

★ 주요 경영진

이사 구 본 천

- 서울대학교 경제학과
- 코넬대 경제학 박사
- 現 LB인베스트먼트 대표이사

이사 구 본 완

- 루이빌대학교 경영학과
- 캘리포니아주립대 MBA
- 現 LB휴넷 대표이사

사외이사 고 광 모

- 서울대학교 사회학과
- 서울대학교 경영학 석사
- 現 다산E&E 대표이사



2000년 ~ 2005년

- 2000.02 마이크로 스케일(주) 회사설립(자본금 10억)
- 2000.06 중소기업청 벤처기업 인증
- 2001.09 삼성전자 EDS TEST 양산 개시
- 2001.11 차세대 일류상품 인증(산업지원부)
- 2002.06 삼성전자 Bump 양산 개시
- 2003.11 500만불 수출의 탑 수상
- 2004.07 최대주주 변경
(황규성 → 밸류미트인베스트먼트)
- 2005.09 최대주주 변경
(밸류미트인베스트먼트 → 구본천)



2006년 ~ 2010년

- 2006.01 LB세미콘(주) 사명변경 / LG DisplayQUAL 인증
- 2006.02 Magnachip 양산 개시
- 2006.10 Siliconworks 양산 개시
- 2007.12 Solder Bump 양산 개시
- 2008.01 COG 품질인증, 양산
- 2009.07 신성장 동력 스마트 프로젝트 참여기업 선정 (시스템 반도체 분야)
- 2009.12 WLCSP 제품 출하
- 2010.01 부설 연구소 설립



2011년 ~

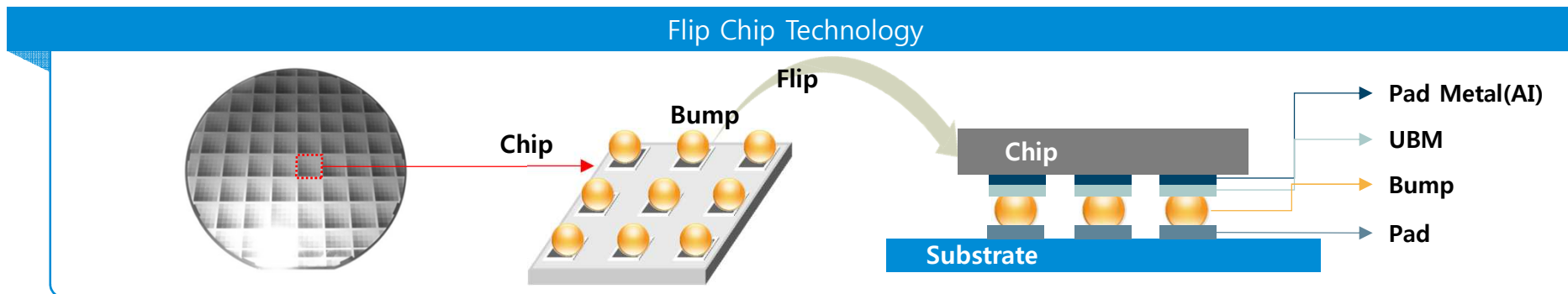
- 2011.01 코스닥 시장 상장
- 2011.04 KDB "글로벌 스타" 선정
- 2012.03 Himax 양산 개시
- 2012.06 PMIC TEST 양산 개시
- 2013.06 Hynix CIS TEST 양산 개시
- 2013.09 12" BUMP 양산 개시
- 2016.01 Novatek 양산 개시
- 2016.12 삼성전자 P.test QUAL 인증
- 2018.02 (주)LB루셈 인수

04.

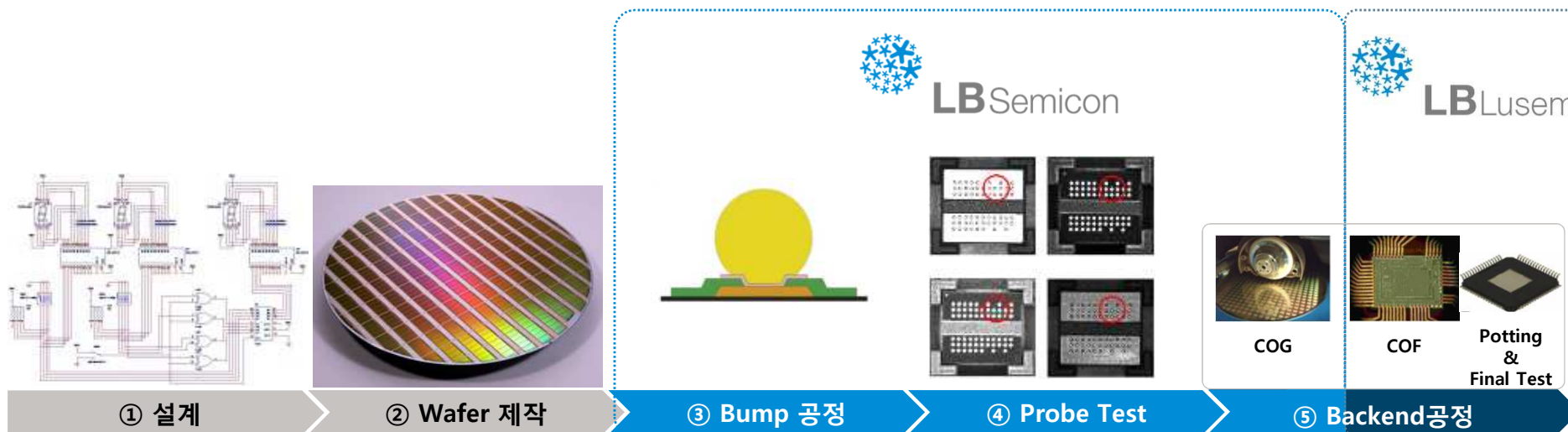
Business Area

Flip Chip 공정 중 핵심인 Bump 공정, Probe test 및 Assembly 일부 공정 사업 영위

★ Flip Chip Technology



★ DDI Flip-Chip Bumping 기준 Process





05.

Business Chain for DDI



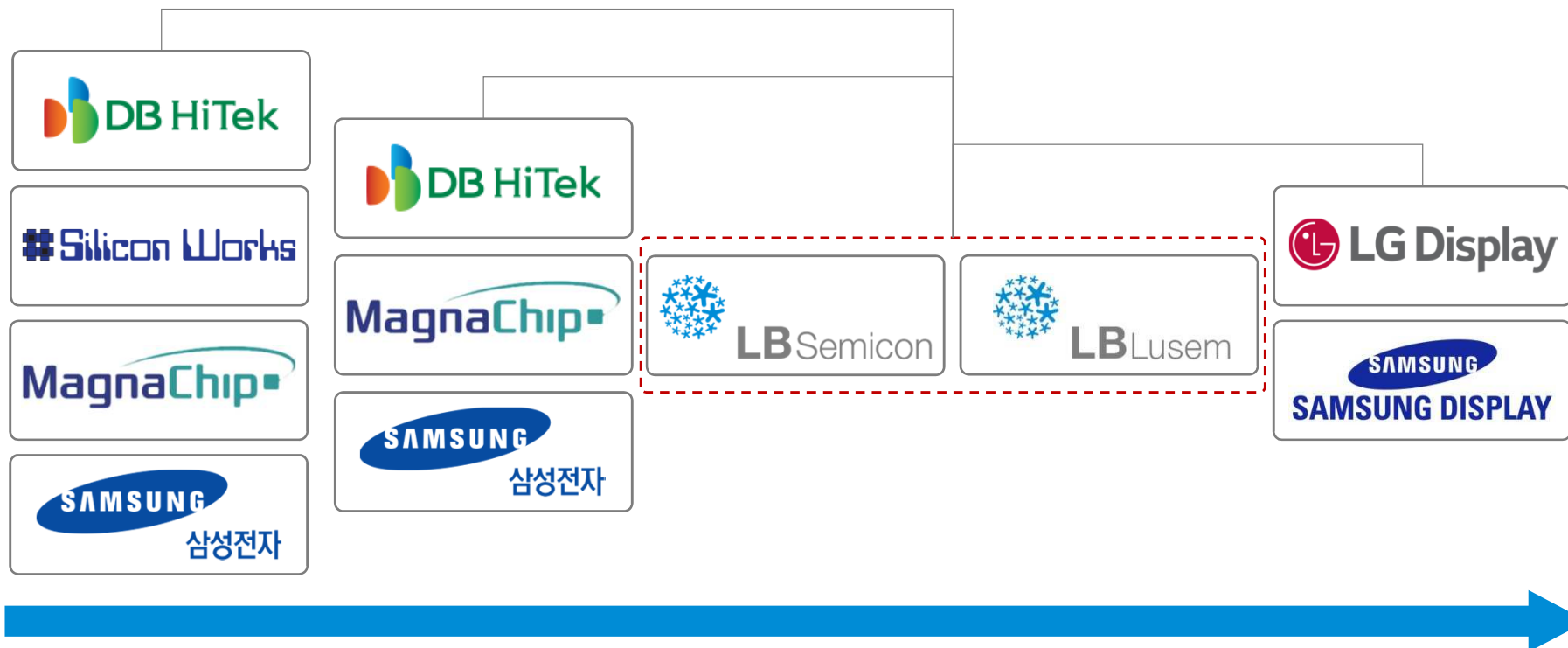
LB Semicon

DDI Bump의 경우 전/후방 산업과의 연관효과가 큰 사업

★ Display Driver IC Value Chain



DDI Bumping 사업의 경우 디스플레이 및 디스플레이 소재/부품사업자와의 Network가 중요



국내외 Major 디스플레이 사업자의 경우 안정적 공급시스템 구축의 일환으로 수직계열화 작업 진행



06.

Financial Highlights



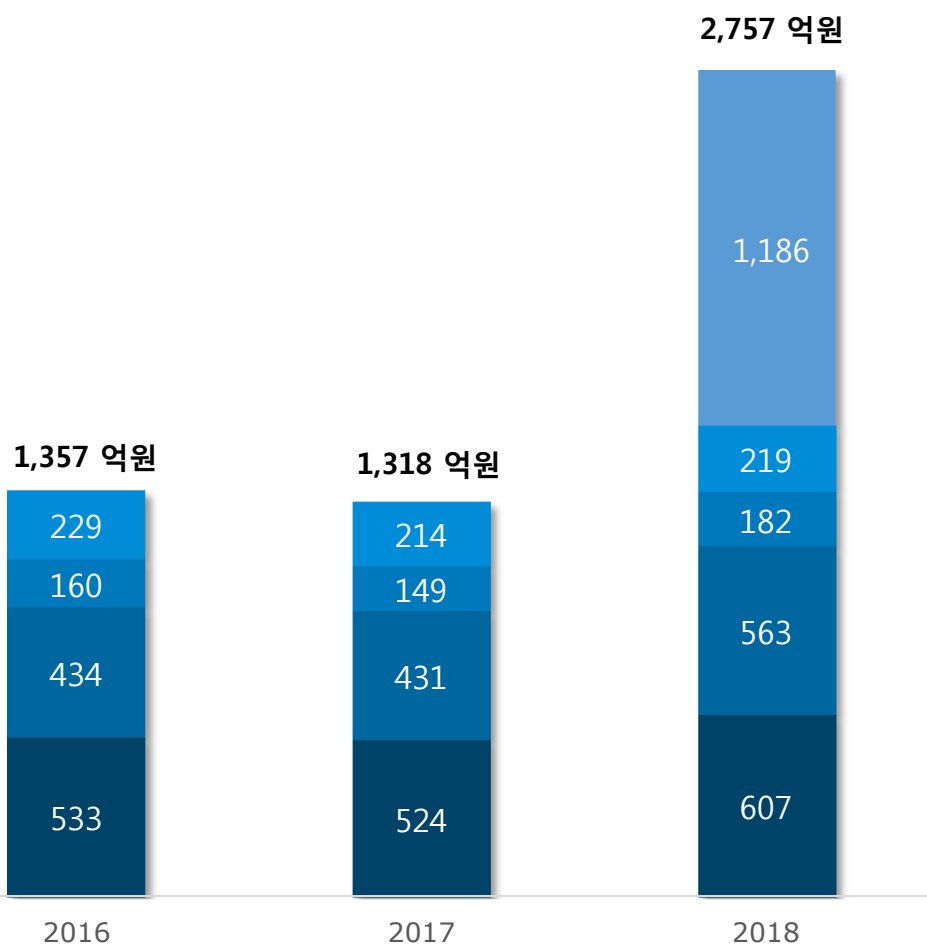
LB Semicon

OLED 패널시장 호조, PMIC/DDI 매출 성장 및 소형 OLED 증가로 인한 매출 증가

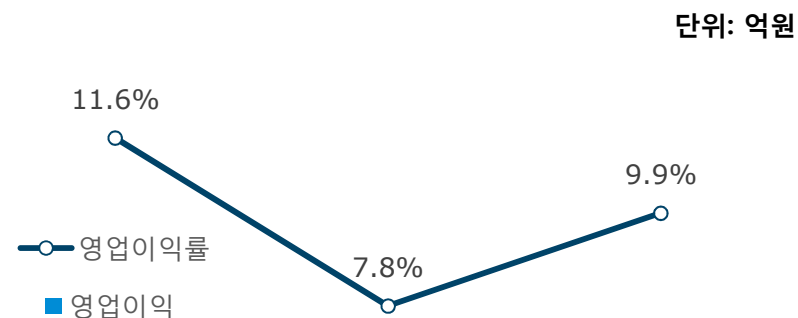
★ 공정별 매출 실적

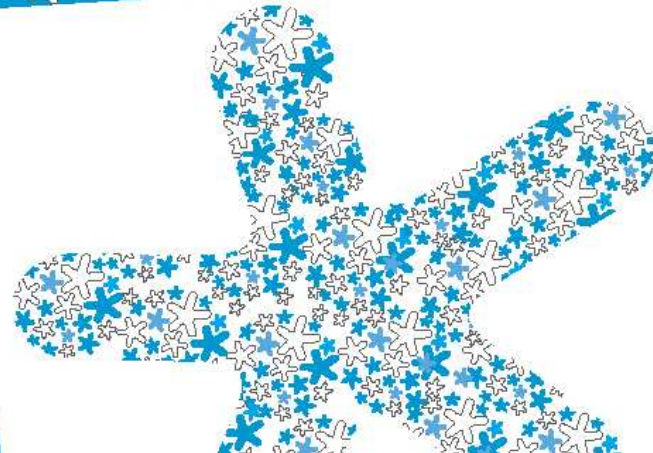
단위: 억 원

■ Au Bump ■ P.Test ■ Solder Bump / WLCSP ■ Backend ■ 사업결합



★ 영업이익 및 영업이익률





Chapter 2: Investment Highlights

01. OLED 패널 시장확대
02. 고객 다변화
03. 어플리케이션 다변화
04. M&A Synergy Effect
05. Vision



01.

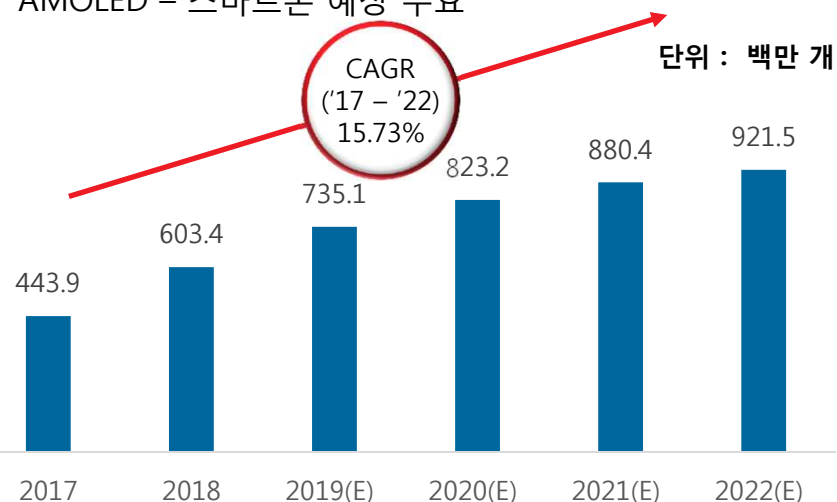
OLED 패널 시장확대



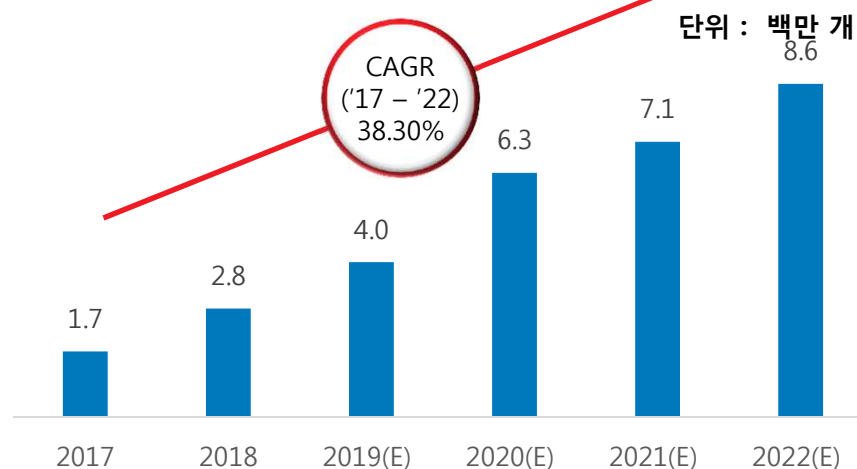
LB Semicon

대형 OLED 패널 시장 확대에 따른 DDI 수요 증가 수혜
국내 패널업체 OLED M/S 확대에 따른 수혜

★ AMOLED – 스마트폰 예상 수요

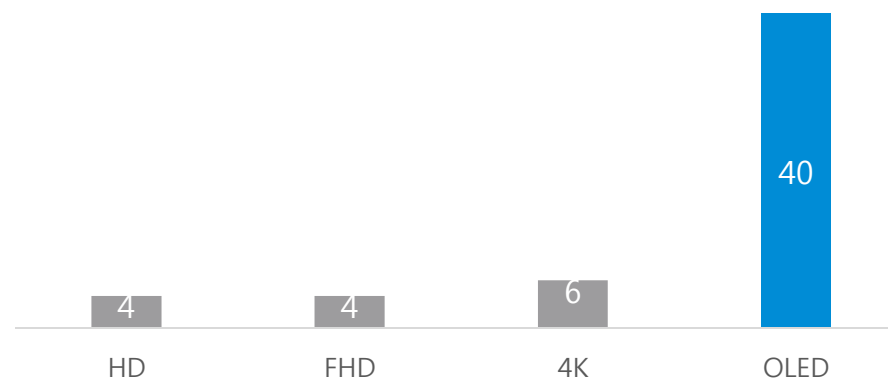


★ AMOLED – TV 예상 수요

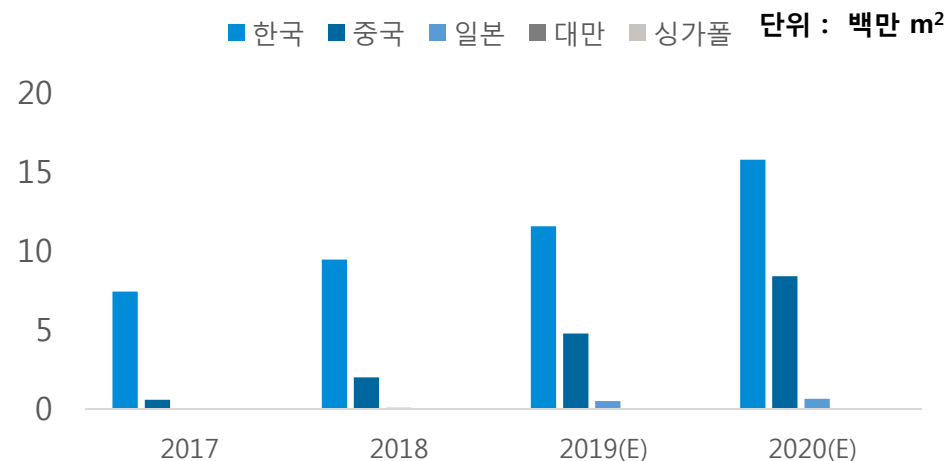


출처: IHS Markit

★ 해상도별 D-IC 채용 수량



★ Global 지역별 AMOLED Capacity

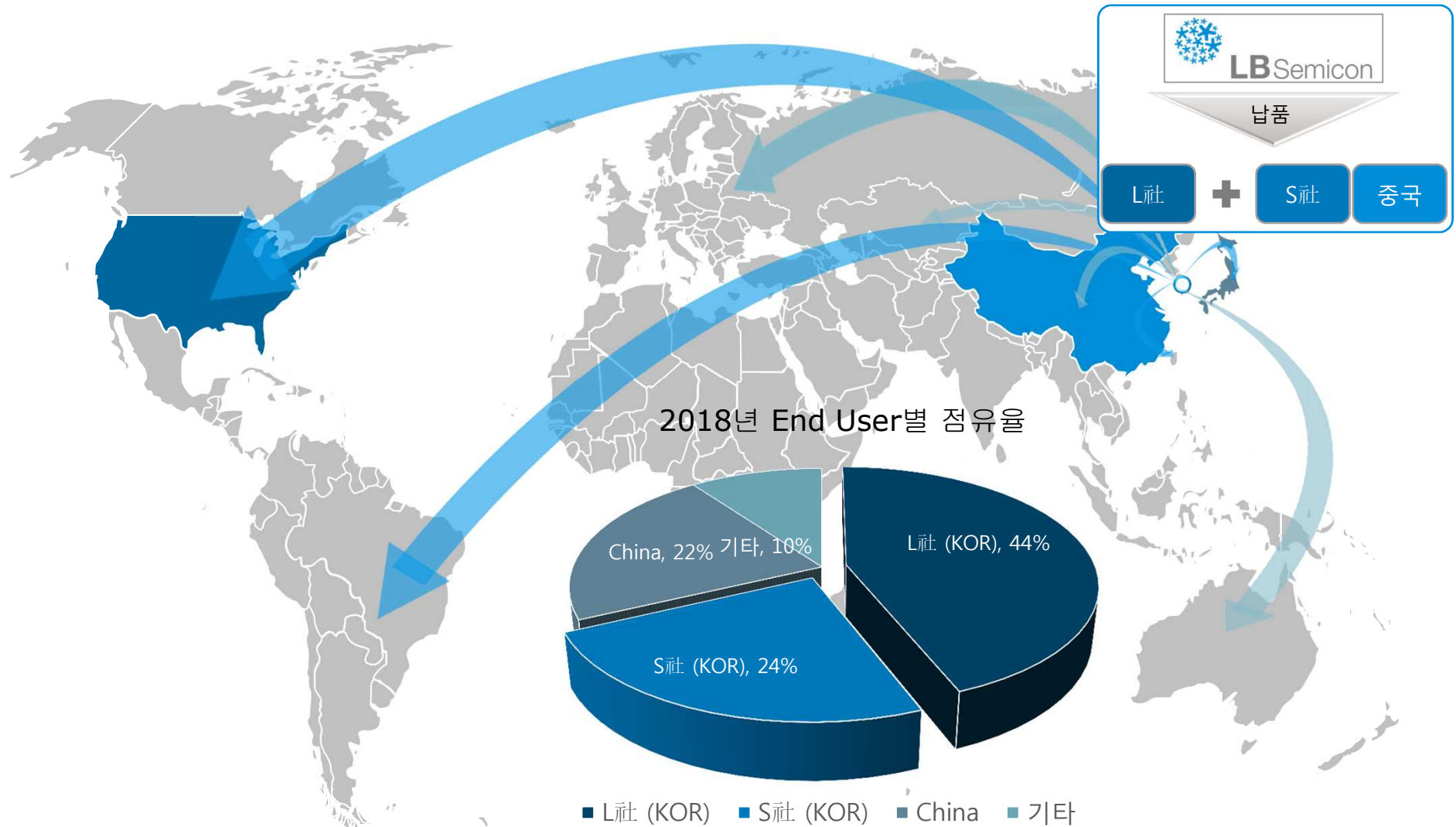


출처: IHS Markit

02.

고객 다변화

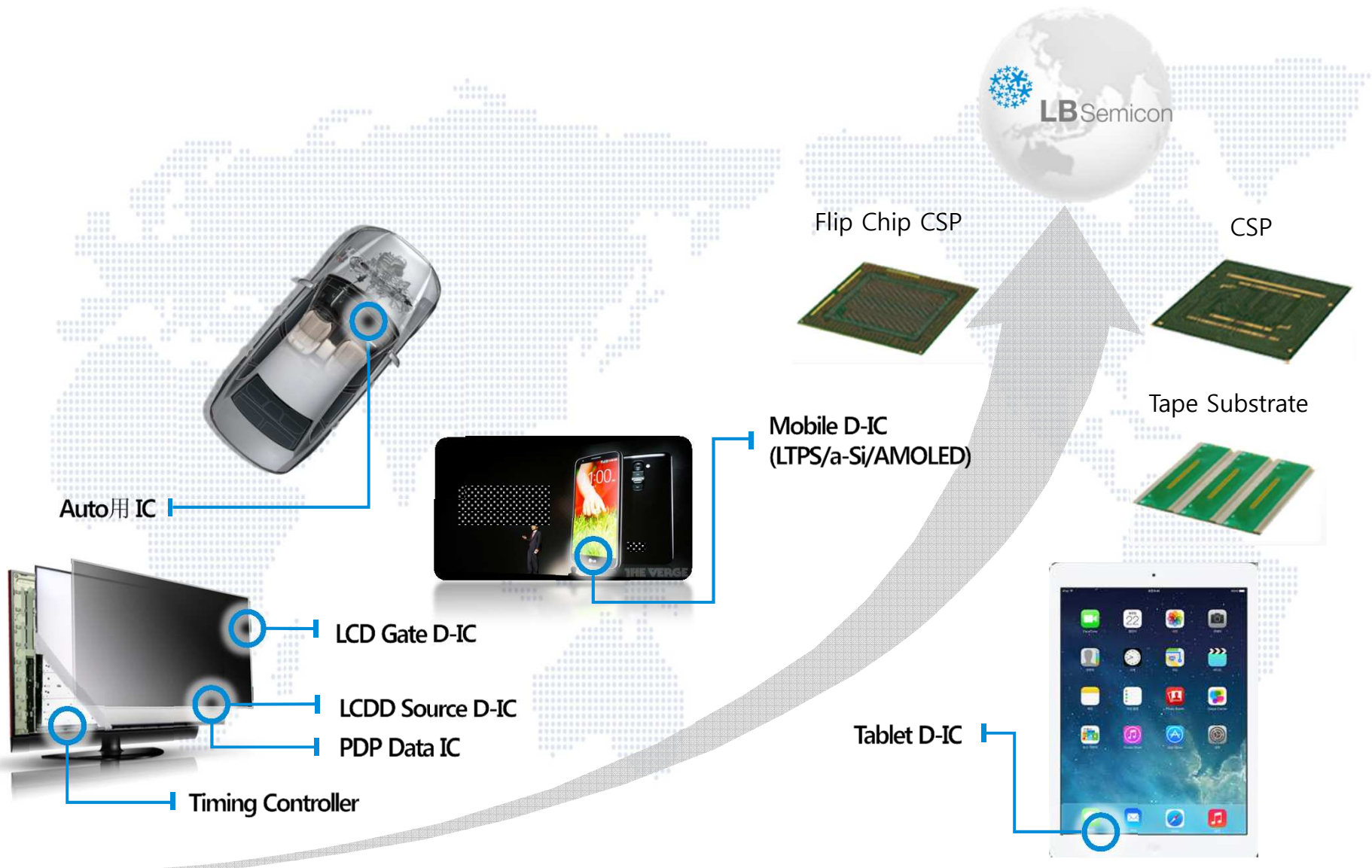
기존 L社에서 S社 및 중국향 매출 증가를 통한 고객 다변화



03.

어플리케이션 다변화

기존 디스플레이 위주의 D-IC에서 PMIC/Memory 등 다양한 어플리케이션 확장





04.

M&A Synergy Effect



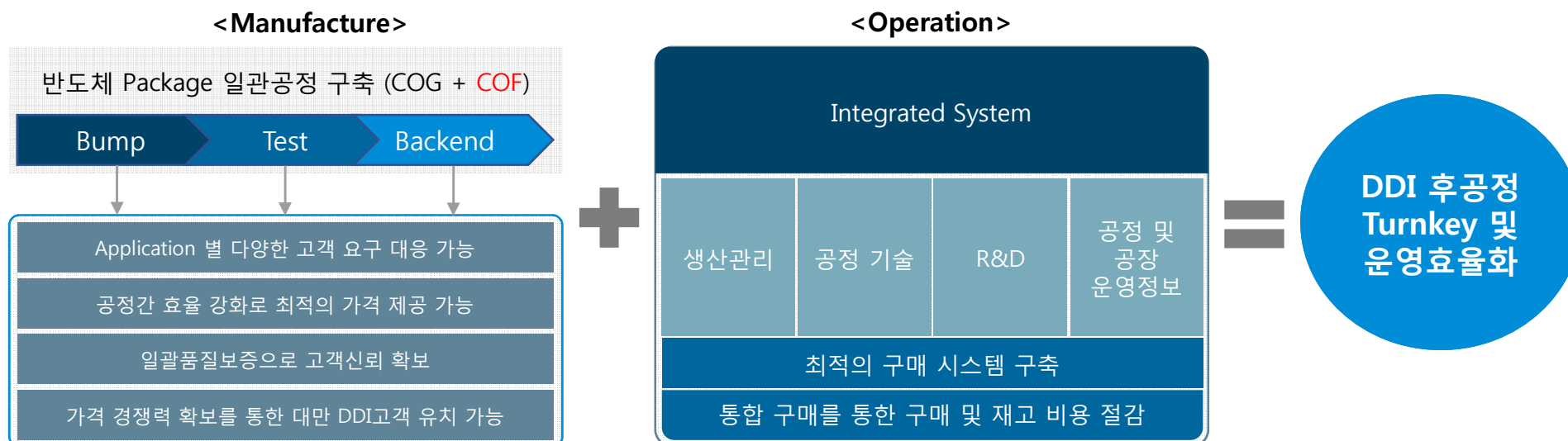
LB Semicon

루셈 인수로 COF영역까지 사업영역을 확대, 기존 영업망을 통한 시너지 효과 창출

★ 기존 LB세미콘 영업망을 활용한 LB루셈의 Global M/S 확대



★ Turnkey service 구축 및 Integrated system 확보를 통한 비용절감





05.

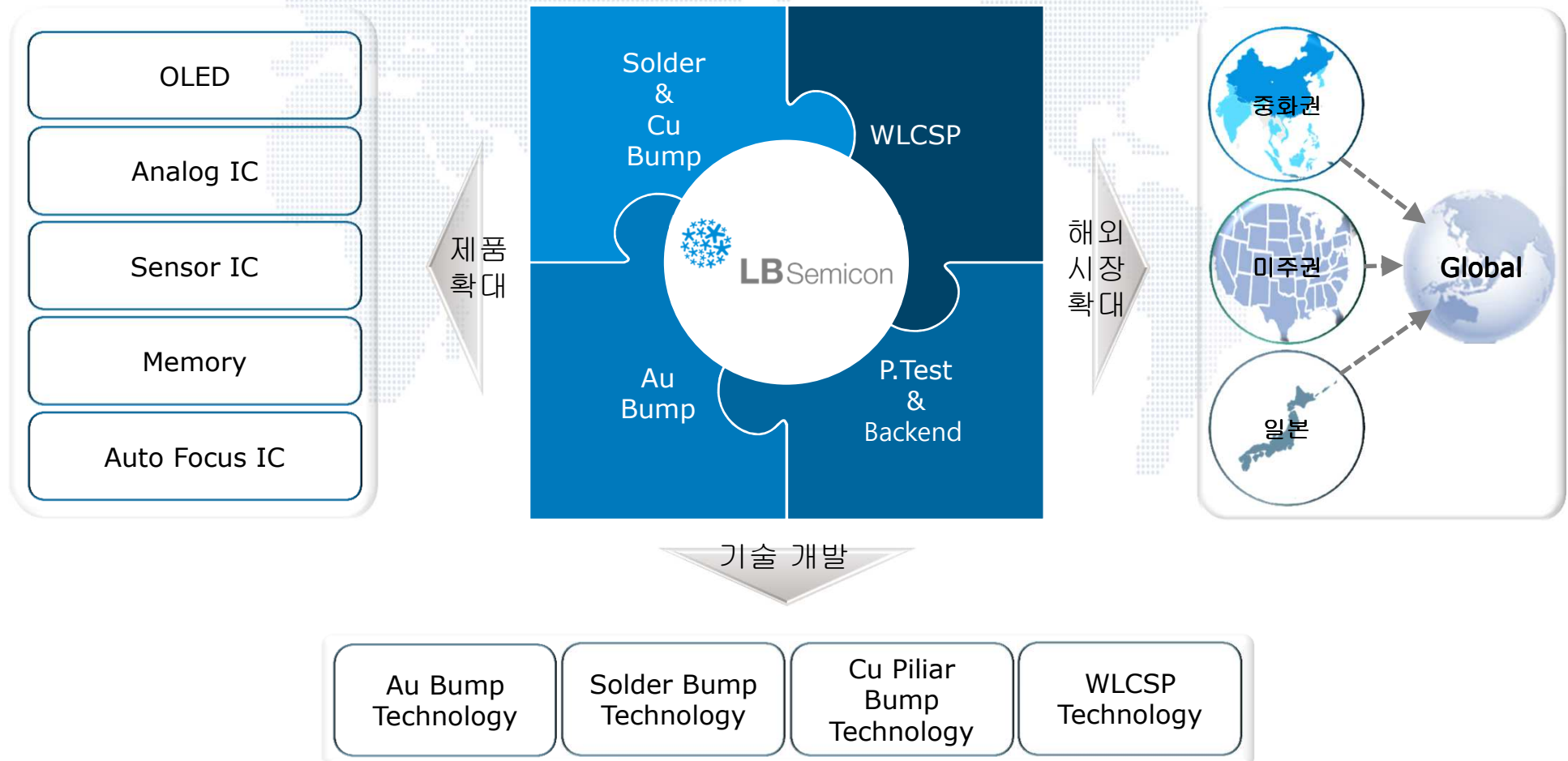
Vision

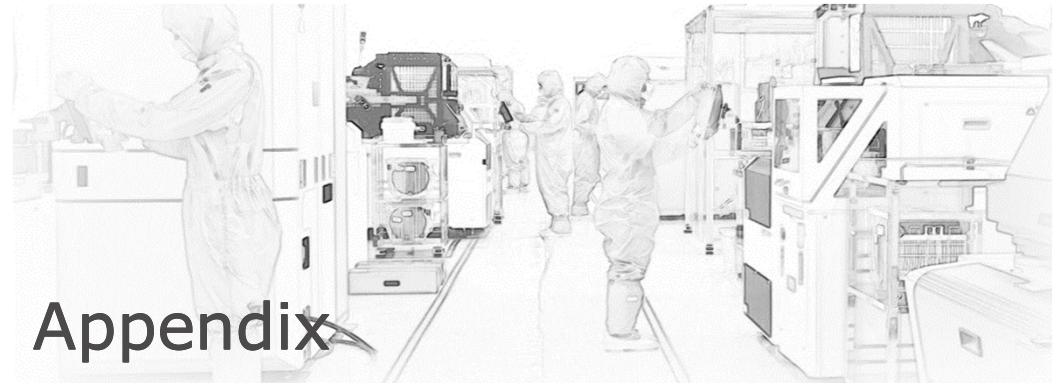
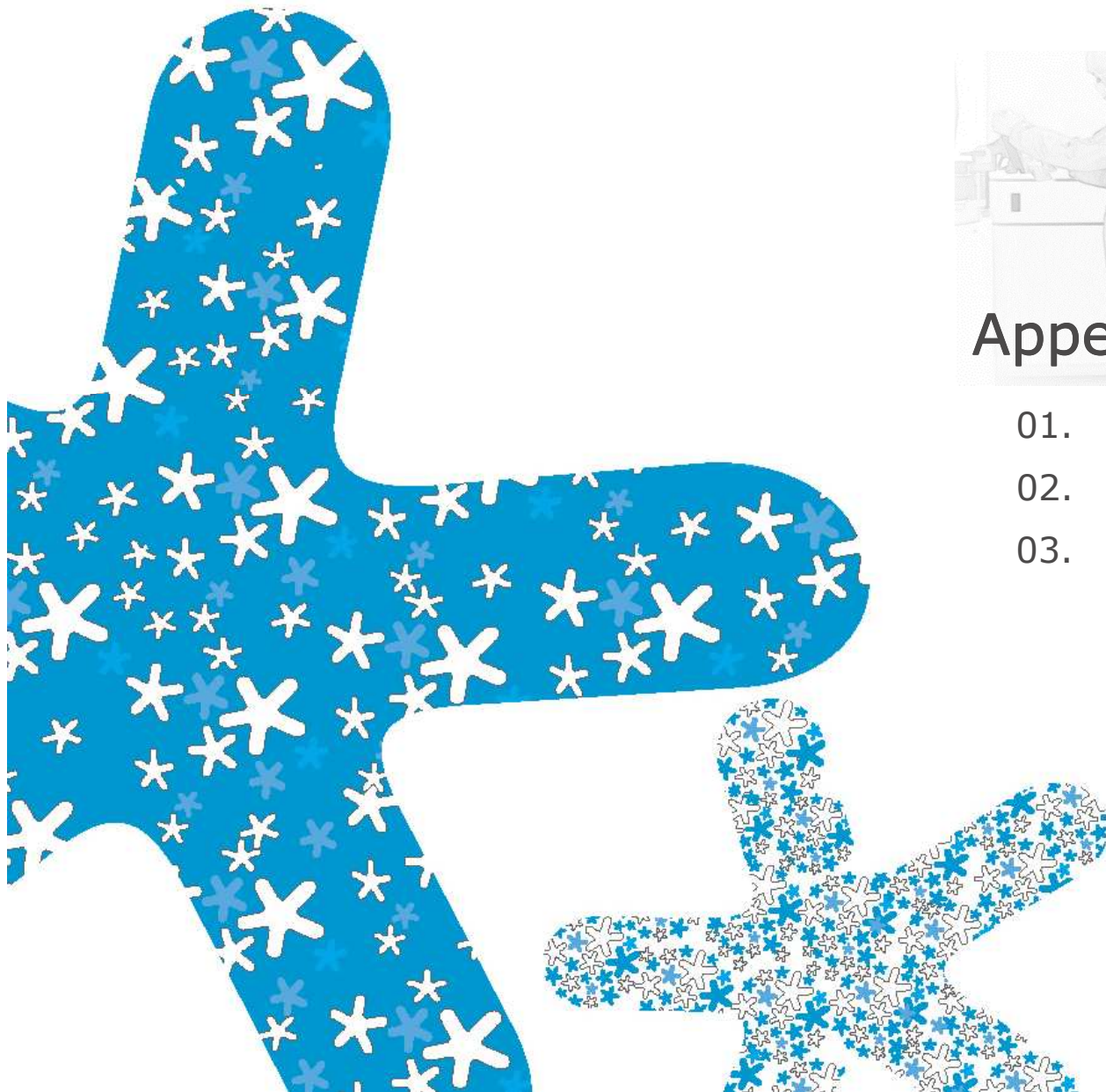


LB Semicon

전방사업의 성장을 선도하는 기술력과 사업영역 확대를 통한 전방위 성장

Global Total OSAT Company





Appendix

- 01. Summary of Financial Statements
- 02. LB루셈 Company Profile
- 03. LB루셈 Summary of Financial Statements



Summary of Financial Statements



LB Semicon

★ 연결재무상태표

(단위: 억원)

구분	2016	2017	2018
유동자산	521	796	1,014
비유동자산	1,602	1,568	2,780
자산총계	2,123	2,364	3,794
유동부채	757	924	1,475
비유동부채	423	436	797
부채총계	1,180	1,360	2,272
자본금	219	219	219
기타자본 구성요소	361	361	361
이익잉여금	362	424	585
비지배지분	-	-	356
자본총계	942	1,004	1,522

★ 연결손익계산서

(단위: 억원)

구분	2016	2017	2018
매출액	1,357	1,318	2,757
매출원가	1,119	1,120	2,295
매출총이익	238	198	462
판관비 등	81	95	187
영업이익(손실)	157	103	274
영업외수익	68	62	59
영업외비용	62	70	86
법인세차감전이익(손실)	163	95	247
법인세비용	28	15	59
당기순이익(손실)	135	80	188
지배지분순이익	135	80	153
비지배지분순이익	-	-	35



Summary of Financial Statements



LB Semicon

별도재무상태표

(단위: 억원)

구분	2016	2017	2018
유동자산	521	796	560
비유동자산	1,602	1,568	2,490
자산총계	2,123	2,364	3,050
유동부채	757	924	1,241
비유동부채	423	436	702
부채총계	1,180	1,360	1,943
자본금	219	219	219
기타자본 구성요소	361	361	361
이익잉여금	362	424	526
자본총계	942	1,004	1,107

별도손익계산서

(단위: 억원)

구분	2016	2017	2018
매출액	1,357	1,318	1,571
매출원가	1,119	1,120	1,306
매출총이익	238	198	265
판관비 등	81	95	100
영업이익(손실)	157	103	165
영업외수익	68	62	34
영업외비용	62	70	77
법인세차감전이익(손실)	163	95	122
법인세비용	28	15	27
당기순이익(손실)	135	80	95



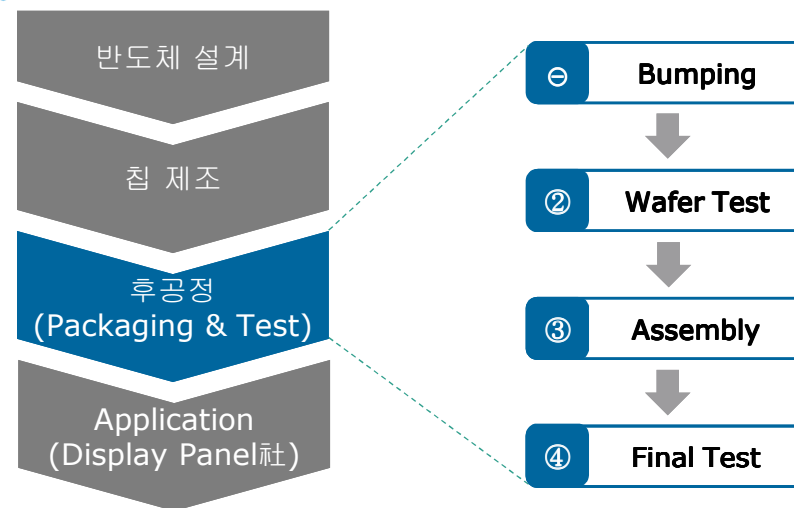
02. LB루셈 Company Profile

★ Company Snapshot



회 사 명	엘비루셈(주)
설 립 일	2004년 7월 7일
대 표 이 사	이 상 훈, 박 노 만
자 본 금	108 억원
임 직 원 수	384 명 (2018년 2월 28일 기준)
주 소	경기도 구미시 4공단로 7길 9 (구포동)
주 요 제 품	Driver IC(TCP, COF), RFID, T-CON
홈 페이지	www.lblusem.com

★ 사업 영역 - 반도체 후공정 임가공 Service 제공



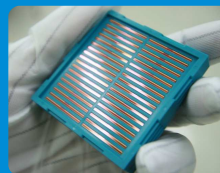
★ 생산 품목 - 디스플레이 구동 Driver IC

COF (Chip On Film)



- Driver IC 칩을 Film 형태로 회로기판(PCB)에 장착
- 주로 TV 및 모니터 등 대화면 기기에 적용
- 최근에는 웨어러블 및 모바일 등의 소형으로 적용 범위 확대

COG (Chip on Glass)



- Driver IC 칩을 디스플레이 패널 위에 직접 탑재
- 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기에 적용
- COF에 비하여 후공정 과정이 간단

